

公司代码：688172

公司简称：燕东微

北京燕东微电子股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”四、风险因素。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	燕东微	688172	不适用

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	霍凤祥	赵昱琛
联系地址	北京市北京经济技术开发区经海四路51号	北京市北京经济技术开发区经海四路51号
电话	010-50973019	010-50973000-8543
传真	010-50973016	010-50973016
电子信箱	bsso@ydme.com	zhaoyc@ydme.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

本公司是半导体技术与制造服务专业提供商，专注为全球客户提供高性能、高稳定的半导体产品及定制化解决方案。核心业务涵盖两大板块：一是制造服务，聚焦逻辑、硅光、功率半导体等领域，提供标准化工艺平台及特色化定制代工服务，满足客户的规模化量产及差异化定制需求；二是产品解决方案，深耕半导体应用细分领域，提供专业可靠的系列产品及解决方案。主要产品应用覆盖消费电子、汽车电子、新能源与电力电子、新兴应用、高稳定等场景。

公司总部位于中国北京，在北京建有 8 英寸晶圆产线和 12 英寸晶圆产线，在四川建有 6 英寸晶圆产线。截至 2025 年底，公司拥有两条 12 英寸生产线，规划月产能 90k；一条 8 英寸生产线，月产能 60k；一条 6 英寸生产线，月产能 65k。

2.2 主要经营模式

公司作为半导体技术与制造服务专业提供商，核心业务采用 Foundry 与 IDM 相结合的经营模式，应用覆盖消费电子、汽车电子、新能源与电力电子、新兴应用、高稳定等多个领域。

Foundry：即晶圆代工模式，公司接受无晶圆厂或设计公司委托，依托自身 6 英寸、8 英寸、12 英寸全系列晶圆生产线及多工艺节点能力，提供晶圆加工及封测服务。主要依托 SiN 硅光、Trench MOS、SGT、IGBT、FRD、SiC SBD、SiC MOS、BCD 等工艺平台，可灵活适配规模化量产与差异化定制需求，为客户输出符合交付标准的产品。

IDM：该模式涵盖芯片设计、晶圆制造、封装、测试全产业链环节，通过设计与制造部门的直接对接，实现技术经验双向反馈，大幅提升芯片从设计到量产的转化效率。依托全流程质量管控与产线协同优势，聚焦分立器件、模拟集成电路等核心产品，为客户提供高质量终端产品与整

体解决方案，尤其在高稳定、车规级、工业级产品领域形成差异化优势，满足不同客户群体的精准需求。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2025年，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下延续增长态势，其中逻辑芯片与存储芯片涨势尤为强劲，根据WSTS数据预计全球半导体市场同比增长22%，规模将达到7,720亿美元。作为我国新型工业化的核心支撑，国内半导体产业同样呈现高景气发展态势，集成电路自主可控、AI算力生态构建、车芯联动深化、先进封装突破等成为年度核心热词，加之国家大基金三期注资赋能，叠加系列财税激励政策持续加码，为产业发展注入强劲动力，推动晶圆代工产能规模实现快速扩张。展望未来，半导体产业市场空间广阔，AI、智能汽车、物联网等新兴应用将驱动需求持续激增，预计2030年市场规模有望突破万亿美元，在国产替代加速推进与政策持续加持的双重作用下，产业增长动力将长期保持强劲。

半导体产业全球化分工格局历经数十年形成，从技术迭代到产能布局均呈现高度协同特征，但发展历程中积累的结构性矛盾日益凸显。早期以效率为导向的全球产业链布局，导致核心环节过度集中于少数国家和地区，形成“单点依赖”隐患，如先进制程晶圆制造、高端光刻胶等关键环节长期被少数企业垄断。同时，技术代差导致后发国家在追赶过程中面临严苛的专利壁垒与技术封锁，叠加地缘政治博弈加剧，原本顺畅的技术转移与协同创新机制受阻，全球供应链从“效率优先”向“安全优先”转型，产业发展的连续性与稳定性受到严重挑战。一方面，先进制程竞赛进入深水区，2nm及以下工艺研发成本指数级攀升，仅少数企业具备量产能力，行业寡头格局加剧，中小厂商创新空间被挤压；另一方面，核心环节“卡脖子”问题突出，EUV光刻机被海外垄断，高端光刻胶、先进制程EDA工具依赖进口。此外，成熟制程领域因国际巨头产能释放引发价格战，叠加国产替代进程中面临的技术验证、人才短缺等问题，产业自主化推进与市场竞争压力形成尖锐矛盾。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是专注于半导体技术研发与制造服务的专业企业，深耕行业近40年，布局成熟制程与特色工艺领域，在国产替代进程中具备重要战略地位。依托完善的产线布局与企业运营优势，公司在集成电路、功率器件等领域积累深厚，形成较强的客户粘性与技术壁垒。

2025年，公司牢牢把握全球半导体产业发展趋势，发扬自身优势，行业地位进一步巩固。研

发方面，公司优化人才结构配置，加大研发投入力度，截至 2025 年底，研发人员达 552 人，全年研发投入 8.02 亿元，营业收入 18.33 亿元，研发投入占营业收入比达 43.74%，远超行业均值。报告期内，公司深化 6+8+12 英寸产线协同，工艺平台持续丰富，技术能力显著提升。制造服务板块，北电集成 12 英寸集成电路生产线项目按照规划节点推进工艺平台建设；燕东科技 12 英寸集成电路生产线一阶段产能迅速释放，单月最高产出突破 2 万片，其中，SOI 硅光工艺平台、0.18um CMOS 工艺平台、功率器件工艺平台均取得关键突破；8 英寸生产线持续提升运营效率，单月最高产出突破 6.5 万片，其中，8 英寸 SiN 平台通过自主研发实现关键工艺指标突破，传输损耗低于 0.1dB/cm，达到行业量产先进水平，成为国内少数具备硅光代工能力的企业，成功卡位全球高速增长硅光赛道；6 英寸生产线持续推进产品结构优化调整，全年产出超 69 万片。产品解决方案板块，公司成功攻克 SOI-CMOS 等特色工艺平台关键技术，实现 54ACS、模拟开关系列、电感隔离器等核心器件自主可控。报告期内，公司综合竞争力持续提升。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025 年，全球半导体产业迎来均衡复苏与创新爆发期，WSTS 预计全年市场规模增长 22% 达 7,720 亿美元，新技术突破、新产业崛起、新业态成型、新模式迭代多点发力，行业从规模扩张转向高质量发展新阶段。

(1) 发展态势

新技术加速突破物理极限，制程工艺竞争白热化，台积电、三星、英特尔分别实现 2nm 及等效工艺量产，对比 3nm，晶体管密度增加 15%，同等功耗下性能提升 15%，同等性能下功耗降低 24-35%。先进封装与三维集成成为关键路径，头部封测企业已建成先进封装产能并实现量产，凭借倒装封装、CPO（光电共封装）、TSV 等多样技术，为 AI、存储、高性能计算等高端芯片提供了可靠的系统级解决方案。有源中介层芯片突破复用性难题，该芯片实现的总 3D 带宽高达 307.2GB/s，同时 3D 接口能效经优化达到 0.142pJ/b。同时，碳化硅光波导技术落地 AR 领域，HBM4 存储芯片量产提速，为 AI 与高端计算筑牢根基。

新产业融合催生增量空间。AI 算力与车规半导体成为核心引擎，国产芯片纷纷适配 AI 数据模型，形成“算卡-服务器-终端”完整生态。存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND 全品类涨价，HBM 成为巨头竞争焦点。

新模式正引领晶圆代工行业竞争变革。国际巨头推行“瘦身”战略，台积电、英特尔等剥离非核心业务，聚焦高毛利赛道。国内企业深耕差异化路径，或攻坚先进制程、或精研特色工艺，

凭在地化布局绑定客户，联动产业链推进设备材料国产化，以技术与生态协同筑牢壁垒，推动行业从单一芯片竞争转向系统级解决方案比拼，生态掌控力成竞争核心。

(2) 未来发展趋势

半导体领域呈技术迭代与生态重构并行趋势。晶圆代工端，国际巨头聚焦 2-5nm 先进节点扩产，国内企业走差异化路线，攻坚特色工艺与国产化适配。封装技术成性能突破核心，台积电 CoWoS、英特尔 EMIB-T 等先进方案迭代，玻璃基板、混合键合技术加速落地。材料工艺方面，国产化进程提速，石墨烯等新型散热材料应用拓展，全产业链协同筑牢自主可控根基。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	37,090,872,201.23	24,060,196,692.14	54.16	18,484,430,578.71
归属于上市公司 股东的净资产	18,330,351,381.47	14,677,831,705.75	24.88	14,859,119,796.56
营业收入	1,833,263,543.04	1,704,338,864.85	7.56	2,126,903,653.81
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	1,788,633,298.24	1,650,954,065.29	8.34	2,056,689,202.82
利润总额	-673,635,372.91	-304,683,897.60	/	455,517,922.37
归属于上市公司 股东的净利润	-407,807,520.25	-178,115,909.79	/	452,292,466.72
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-896,601,055.49	-288,028,775.12	/	291,503,381.80
经营活动产生的 现金流量净额	580,342,989.51	318,684,153.62	82.11	402,768,425.36
加权平均净资产 收益率(%)	-2.52	-1.21	减少1.31个百分 点	3.10
基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.15	/	0.38
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.15	/	0.38
研发投入占营业 收入的比例(%)	43.74	19.91	增加23.83个百分 点	13.92

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	227,648,859.92	431,292,429.36	507,726,838.47	666,595,415.29
归属于上市公司股东的净利润	-210,612,492.47	338,217,830.87	-141,005,771.07	-394,407,087.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-215,094,665.61	-174,750,047.89	-158,697,245.02	-348,059,096.97
经营活动产生的现金流量净额	-3,016,562.33	224,169,345.14	-377,218,763.96	736,408,970.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							18,802
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,821
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京电子控股有 限责任公司	225,083,986	645,657,112	45.23	645,657,112	无	0	国 有 法人
北京亦庄国际投 资发展有限公司	-14,276,180	154,636,709	10.83	0	无	0	国 有 法人
天津京东方创新 投资有限公司		93,164,110	6.53	0	无	0	国 有 法人
国家集成电路产 业投资基金股份 有限公司	-26,267,221	86,747,202	6.08	0	无	0	国 有 法人

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	-29,723,330	71,380,905	5.00	0	无	0	其他
盐城高新区投资集团有限公司		45,205,769	3.17	0	无	0	国有法人
北京电子城高科技集团股份有限公司		22,602,884	1.58	0	无	0	国有法人
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司		17,074,784	1.20	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	10,000,000	10,000,000	0.70	0	无	0	其他
中国长城资产管理股份有限公司	-9,821,429	9,316,464	0.65	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

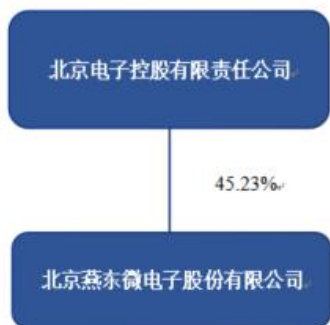
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 183,326.35 万元，较上年同期增长 7.56%；实现利润总额-67,363.54 万元，较上年同期下降；实现归属于上市公司股东的净利润-40,780.75 万元，较上年同期下降；报告期末公司总资产 3,709,087.22 万元，较期初增长 54.16%；归属于上市公司股东的净资产为 1,833,035.14 万元，较期初增长 24.88%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用